

<<微电子技术用贵金属浆料测试方法>>

图书基本信息

书名：<<微电子技术用贵金属浆料测试方法>>

13位ISBN编号：9785066131523

10位ISBN编号：5066131523

出版时间：2008-6

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<微电子技术用贵金属浆料测试方法>>

内容概要

《微电子技术用贵金属浆料测试方法:附着力测定(GB/T 17473.4-2008)》为GB / T 17473—2008的第4部分。

《微电子技术用贵金属浆料测试方法:附着力测定(GB/T 17473.4-2008)》代替GB / T 17473.4—1998《薄膜微电子技术用贵金属浆料测试方法 附着力测定》。

《微电子技术用贵金属浆料测试方法:附着力测定(GB/T 17473.4-2008)》与GB / T 17473.4—1998相比，主要有如下变动：将原标准名称修改为：微电子技术用贵金属浆料测试方法 附着力测定；将原标准中去除“非贵金属电子浆料附着力测定也可参照本标准执行”内容；增加了SnAg3.0Cu0.5焊料用于无铅导体焊接；用隧道烧结炉取代原标准中的带式炉；增加了无铅焊料的温度控制。

《微电子技术用贵金属浆料测试方法:附着力测定(GB/T 17473.4-2008)》由中国有色金属工业协会提出。

《微电子技术用贵金属浆料测试方法:附着力测定(GB/T 17473.4-2008)》由全国有色金属标准化技术委员会归口。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>